



H2008 绝缘胶

H2008 是一款单组分、高触变性环氧绝缘胶，固化速度快，可操作时间长，固化后粘接强度高、耐温性优异，专为微电子及光电子领域的芯片粘接设计。本产品适用于自动点胶、手工探针等工艺。

产品描述

产品特性

条目	描述
技术类型	环氧
外观	白色膏体
组分	单组分
固化方式	热固化
典型的产品应用	光电子芯片粘接等

产品优点

- 单组分绝缘胶
- 可快速固化
- 适合快速点胶

产品性能

未固化时性能

条目	典型值	备注
粘度 cps	20000±2000	GB/T 2794, 博勒飞 CP51, 5rpm
触变指数	4.5±1	GB/T 2794, 0.5rpm/5rpm
比重 g/cm ³	1.1±0.1	GB/T 13354
工作时间	3 天	@ 25° C, 25% 粘度上升

固化后性能

在推荐的条件下固化：

条目			典型值	备注
物理性能	热膨胀系数 ppm/°C	Tg 以下	80	TMA, 升温速率 5°C/min
		Tg 以上	172	
	玻璃化转变温度 °C		110	TMA



硬度 Shore D	90	ISO 868
热导率 W/(m · K)	0.25	ASTM D5470
体积电阻率 $\Omega \cdot \text{cm}$	1×10^{14}	/
饱和吸水率 %	0.38	85°C/85RH
拉伸剪切强度 N/mm ²	>14 (Al/Al)	ISO 13445

典型的固化性能

固化条件

条目	典型值
热固化	30 分钟 @165°C

以上固化条件仅是推荐的指南。固化条件（时间和温度）应依据客户经验、应用要求、固化设备、烤箱负载、实际烤箱温度而不同。

使用说明

在使用前必须将样品垂直放置恢复到室温，在恢复到室温以前请不要打开铝箔包装(建议回温时间大于 2 小时)。胶水对湿度敏感，请不要将胶水长时间暴露在空气中，建议使用环境相对湿度低于 60%，回温次数不超过三次。

本品在 25°C，相对湿度 < 60%的条件下，使用期是 3 天。

未用完的胶，请先放入塑料袋内密封后再放入冰箱贮存。

注意事项

有关本产品的安全注意事项，请查阅安全数据资料。

标准包装

- 10ml , 30ml / 支
- 根据客户要求

产品储存

本产品无毒性、无危险性，遵循标准化学品运输和储存。

将产品存贮于未开封的原装容器内，并存放在干净、干燥的区域。存储信息同时标注于产品外包装标签。

本产品最佳存储条件：-40°C~-20°C，存储期 6 个月。



为防止未使用产品受到污染，请不要将任何材料放回原装容器。本公司不对在所述情况以外的条件下被污染或储存的产品承担责任。更具体的保存期限信息，请咨询 Hanlicon 应用工程师。

注：本文中所含的各种数据仅供参考。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。自行决定把本产品用在本文中提及的产品应用外，及未采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是用户自己的责任。本公司明确声明对所有因销售公司产品或特定场合下使用本公司产品而出现的问题，包括针对某一特殊用途的适用性问题，我们不承担责任。公司明确声明对任何必然的或意外损失都不承担责任。建议用户每次在正式使用前都要根据本文提供的数据先做实验。

湖南创瑾科技有限公司

中国湖南省长沙市宁乡经济技术开发区谐园北路

中国长沙智能终端产业园 5 号栋

Tel: +86-731-87827556

www.trumjin.com